



応用物理学会応用電子物性分科会主催

応用電子物性分科会 研究例会

我が国の最先端半導体製造技術の夜明けと未来

最先端半導体製造技術の確立と産業化が我が国の重要課題となっています。本シンポジウムでは、半導体産業と研究開発の第一線で活躍されている方々を講師としてお招きし、最先端半導体の研究開発における課題、半導体が切り開く日本の未来、そして若い世代への期待についてご講演いただきます。

日時：2024年1月10日（水） 13:00～16:50

会場：東京工業大学 蔵前会館 ロイヤルブルーホール
（東急大井町線大岡山駅徒歩1分）

<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/>

演題：

- 13:00～13:10 応用電子物性分科会幹事長挨拶
- (1) 13:10～13:50 「プラズマ科学の進化による最先端半導体製造技術の変革」
堀 勝（名古屋大学）
- (2) 13:50～14:30 「自動車産業における半導体技術研究開発
その難しさ面白さ」
加地 徹（名古屋大学）
- (3) 14:30～15:10 「半導体製造プロセスへの情報技術の適用」
守屋 剛（東京エレクトロン株）
— 休憩（20分） —
- (4) 15:30～16:10 「次世代に向けての先端半導体材料探索とデバイス開発」
熊倉 一英（NTT 物性科学基礎研究所）
- (5) 16:10～16:50 「半導体ビジネスから見た業界と人材の過去と将来」
佐藤 仁（マイクロンメモリジャパン株）

受付：[\[こちら\]](#) から受付をお願いいたします。

参加費（テキスト代・消費税込み）：

分科会会員：3,000円，応用物理学会会員（分科会非会員）：7,000円
応用物理学会会員（シニア会員）：2,000円，一般：12,000円，学生：2,000円
* 応電分科会賛助会員の方は1社につき1名まで無料。2人目から通常の参加費。

問合せ先：大見 俊一郎（東工大） E-mail: ohmi@ee.e.titech.ac.jp
重川 直輝（大阪公立大学） E-mail: shigekawa@omu.ac.jp
野村 政宏（東京大学） E-mail: nomura@iis.u-tokyo.ac.jp
小田 康代（応用物理学会事務局） E-mail: divisions@jsap.or.jp

（スパム対策のため、上の“@”は全角になっています。半角の“@”に置き換えて下さい。）
応用電子物性分科会ホームページ：<http://annex.jsap.or.jp/ohden/>